

NUMBER 178139

3rd ANGLE PROJECTION

METRIC

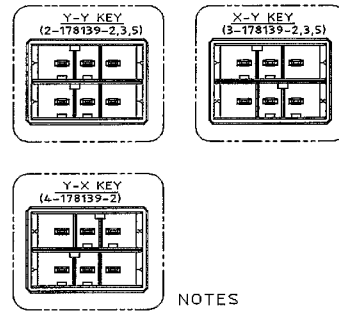
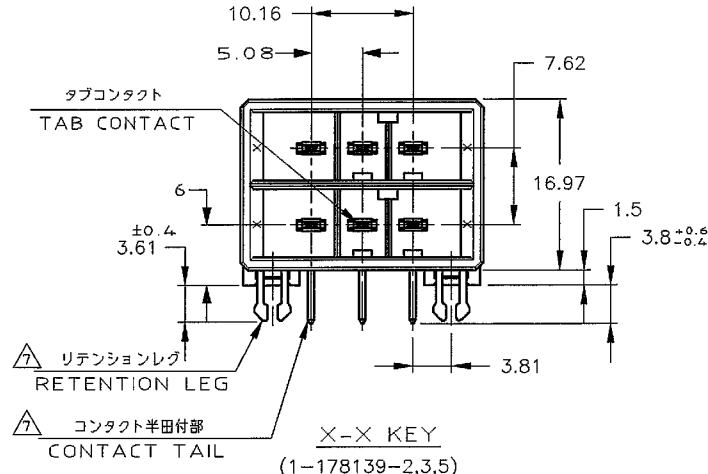
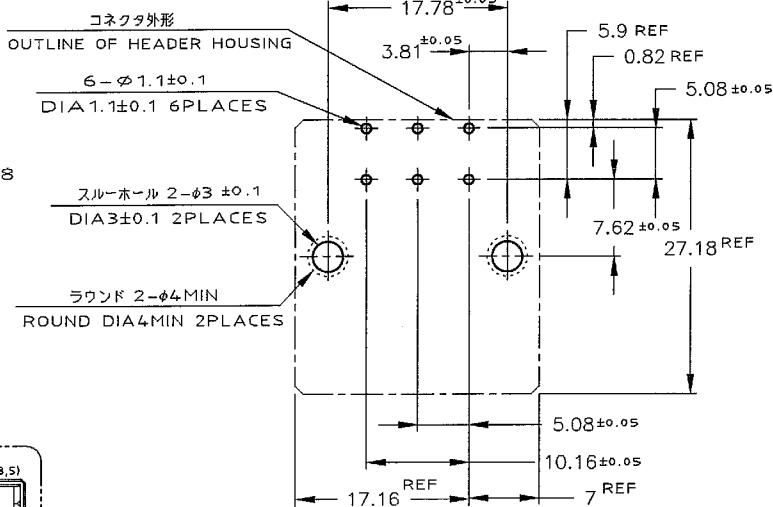
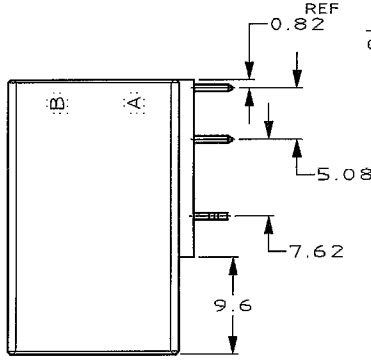
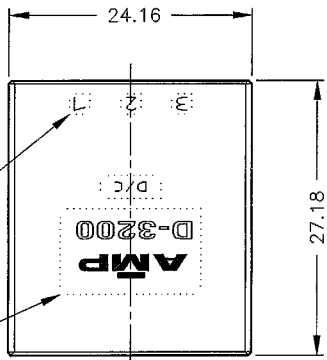
DIMENSIONS IN MILLIMETERS, DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/93

回路番号
CIRCUIT NO

AMPマーク
シリーズマーク
SERIES MARK



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚:1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS:1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC,POLYESTER
CONTACT:CUPPER ALLOY
RETENTION LEG:CUPPER ALLOY
2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
4. FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN PLATED OVER NICKEL
5. FINISH(RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED-(CONTACT TAIL) OVER NICKEL
6. PRODUCT SPEC: 108-5349
7. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注 記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエスデル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
6. 製品規格: 108-5349
7. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

△	△	1,2,3-178139-5
△	△	1,2,3-178139-3
△	△	1,2,3,4-178139-2
(FINISH)	製品番号 (PART NO.)	

				Copyright © 1995# タイコ・エレクトロニクス・アンプ株式会社				Copyright © 1995 Tyco Electronics AMP K.K. ALL RIGHTS RESERVED.				tyco Electronics				Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan							
				WIRE RANGE				INSULATION DIA				NAME											
				mm² (AWG -)				mmφ				6 POS SINGLE ROW											
D REVISED (FJD0-0039-03)				TS		S.M		MATERIAL				FINISH				HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3200							
C REVISED (FJD0-0097-03)				T.S		S.M		SEE NOTE 注意参照				SEE NOTE 注意参照				SIZE LOC NUMBER							
B REVISED (FJ00-0654-02)				T.S		S.M		DR. 29/MAR/95 K.IKEDA				DE. 29/MAR/95 K.IKEDA				C=178139							
A1 REDRAWN(FJ00-2183-65)				K.I		S.M		CHK. 23/MAR/95 S.MANABE				APP. 23/MAR/95 S.MANABE				SCALE REV. SHEET							
LTR REVISION RECORD				DR		CHK DATE										2-1 D 1 of 1							

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面